江苏本川智能电路科技股份有限公司

证券代码:300964 证券简称:本川智能 公告编号:2025-012

2024 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变更,为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截至本次会议召开日公司总股本77,298,284股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份970,000股后的股本76,328,284股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	本川智能	股票代码	300964
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孔和兵	董超	
办公地址	南京市溧水经济开发区孔家路7号	南京市溧水经济开发区孔家路7号	
传真	0755-23490981	0755-23490981	
电话	0755-23490987	0755-23490987	
电子信箱	security@allfavorpcb.com	security@allfavorpcb.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司自成立以来,始终致力于为市场提供各类印制电路板产品及解决方案,专业从事印制电路板的研发、生产和销售,立足于小批量板领域,并在PCB相关领域具有丰富的行业经验和深厚的技术积累。公司主要业务近年来未发生重大变化。

公司通过长期技术研发和积累,积极拓展多种技术方向和特殊材料产品,形成了丰富的产品体系,拥有高频高速板、多功能金属基板、厚铜板、挠性板、刚挠结合板、HDI板、热电分离铜基板、镜面铝基板、陶瓷基板等多种技术方向和特殊材料产品的生产能力,能够满足客户多品种的产品需求。公司印制电路板产品定位于中高端应用市场,具有高精度、高密度和高可靠性等特点,产品以通信设备、汽车电子、新能源为核心应用领域,长期深耕工业控制、电力、医疗器械等应用领域,并逐步向其他前沿应用领域探索。

(二)主要产品及其用途

1、公司产品体系丰富,经过长期技术研发和积累,可以提供多种技术方向和特殊材料产品,能够满足客户多品种的产品需求。

(1)按导电图形层数分类

PCB按照导电图形层数可分为单面板、双面板和多层板三大类,公司生产的PCB产品以双面板和多层板为主。

产品种类	特征描述
单面板	绝缘基板上仅有一面具有导电图形的PCB,零件集中在其中一面,导线集中在另一面上,是最基本的PCB
双面板	绝缘基板的两面都具有导电图形,由于两面都具有导电图形,需通过导孔将两面的线路连接。双面板解决了单面板中布线交错的问题,可以用在较复杂的电路中
多层板	有四层及以上导电图形的印制电路板,内层由导电图形与绝缘材料压制而成,外层为铜箔。层间导电图形通过导孔进行互连。多层板层数通常是偶数,可用在复杂电路中

(2)按基材柔软度分类

PCB按照基材投入柔软度可分为刚性板、挠性板和刚挠结合板,公司产品已覆盖全部类型。

产品种类	特征描述
刚性板	是由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成的印制电路板,具有抗弯能力,可以为附着其上的电子元件提供一定的支撑。刚性基材包括玻纤覆铜基、纸基、复合基、陶瓷基、金属基、热塑性基等
挠性板	采用柔性的绝缘基材制成,可根据安装要求进行弯曲、卷绕、折叠。挠性基材包括聚酰亚胺基、聚酯基等
刚挠结合板	由刚性板和挠性板有序地层压组成,通过金属导孔进行电气连接,既可以提供刚性板的支撑作用,又具有挠性板的弯曲性,能满足三维组装的要求。主要基材包括玻纤覆铜基、聚酰亚胺基等

(3)按技术方向分类

按技术方向分类,公司生产的产品包括高频高速板、金属基板、厚铜板、HDI板、热电分离铜基板、镜面铝基板、陶瓷基板等多种类型。

产品种类	特征描述
高频高速板	高频高速板是指使用特殊的低介电损耗材料生产出来的印制电路板,具有较高的电磁频率。一般来说,高频可定义为频率在1GHz以上。高频高速板在基材的选取方面有较高的要求,基材一般选取在介电常数、传输损耗因子等方面表现优异的陶瓷基板或有机基板。同时,高频高速板对加工工艺提出了更高的要求,具体体现在对图形精度、层间对准度和阻抗控制方面要求更为严格,因而价格较高
金属基板	金属基板是由金属基材、绝缘介质层和电路层三部分构成的复合印制线路板,具有散热性优良、机械强度高、加工性能好等优点,主要应用于发热量较高的电路上。根据金属材质的不同,可进一步分为铜基板、铝基板和铁基板
厚铜板	厚铜板是指使用厚铜箔(铜厚在3OZ及以上)或成品任何一层铜厚为3OZ及以上的印制电路板。厚铜板具备承载大电流及高电压的特性,同时具有较好的导电性能
HDI板	HDI板(High Density Interconnector),即高密度互连板,是使用微盲埋孔技术的一种线路分布密度比较高的电路板。HDI板有内层线路和外层线路,通过钻孔、孔内金属化等工艺,使各层线路内部实现连结。HDI板一般采用积层法制造,积层的次数越多,板件的技术水平越高。相较于传统的印制电路板,HDI板具有电性能良好、抗射频干扰能力强、抗电磁波干扰能力强、热传导效果良好等特点。同时,HDI板大幅提高了板件布线密度,降低了印制电路板的体积,使终端产品设计更加小型化
热电分离铜基板	热电分离铜基板是一种专为解决大功率电子产品散热问题而设计的高性能散热材料。其特点是通过将电路部分与热层部分在不同线路层上分离,使得热层直接接触发热元件,实现高效的热传导,导热系数远高于普通铜基板,降低了热阻,有效散热减少了元件的温升,延长了电子产品的使用寿命。热电分离铜基板市场正处在成长阶段,技术优势明显,主要应用于大功率LED照明、汽车电子、绝缘栅双极晶体管(IGBT)模块封装、通信基站、卫星通信、数据中心服务器等对散热要求极高的领域,热电分离铜基板的应用需求日益增加
镜面铝基板	镜面铝基板是一种具有高反射率和良好散热性能的特殊金属基电路板,其采用热电分离技术和COB(板上芯片封装)封装工艺,导热系数远高于普通铝基板,其表面处理技术镀银,可以增强反光效果,提高产品的光学性能和使用寿命。镜面铝基板市场展现出积极的增长趋势和广阔的市场前景,因其具有高反射率(可达98%)、良好的散热性能以及优异的焊接性能等优点,使其在多个领域得到广泛应用,包括LED照明、电力电源(电源模块、功放器、电机驱动器等)、汽车电子(车灯、仪表盘、导航系统、电子控制单元等)、通信设备、航空航天(导航系统、卫星等)、COB封装、太阳能电池、新能源等领域。随着技术的发展和应用需求的增加,预计镜面铝基板的市场前景将更加广阔
陶瓷基板	1、直接镀铜(DPC)陶瓷基板,是一种在陶瓷薄膜工艺加工基础上发展起来的陶瓷电路加工工艺。它以氮化铝或氧化铝陶瓷作为基板,通过溅镀工艺在基板表面复合金属层,再利用电镀和光刻工艺形成精细的电路图案。2、直接覆铜(DBC)陶瓷基板,是一种将铜箔通过高温熔融直接与陶瓷表面结合的复合基板材料,具有高绝缘性、高导热性、高强度和低热膨胀系数等特点。3、陶瓷BT复合基板,结合了陶瓷基板的高导热性、高绝缘性、高强度和低热膨胀系数等特点,以及树脂(BT)基板的易加工性和成本效益。其在电子封装领域尤其是功率电子器件的封装中有着广泛的应用,主要应用领域包括新能源汽车(电池管理系统、电机控制器等)、LED照明(大功率LED)、航空航天、工业控制、医疗、半导体行业(集成电路和功率模块的封装)、光风储新能源(逆变器等关键组件)、市场前景广阔。4、AMB活性钎焊陶瓷基板,通过在陶瓷基板表面涂覆含活性元素的钎料,并与铜层在高温真空条件下进行钎焊,实现陶瓷与金属的紧密结合。与DPC(直接镀铜工艺)、DBC(直接覆铜工艺)等工艺相比,其具有更高的热导率、更好的铜层结合力,以及更小的热阻和更高的可靠性。

2、公司印制电路板产品定位于中高端应用市场,具有高精度、高密度和高可靠性等特点,产品以通信设备、汽车电子、新能源为核心应用领域,长期深耕工业控制、电力、医疗器械等应用领域,并逐步向其他前沿应用领域探索。

公司PCB产品重点应用领域

应用领域	具体应用
通信设备	宏基站、小基站、光模块、低空卫星等
汽车电子	新能源汽车"大三电"和"小三电"、毫米波雷达、超声波雷达、BMS系统、智能驾驶、智能化座舱、中控及高端娱乐系统等
新能源	储能、充电桩、光伏发电、风力发电、清洁能源等
工业控制	工业机器人、工业控制板、工业监控系统、工业检测仪、电动工具等
电力	智能电网、智能电表、电力系统保护和控制等
医疗器械	CT、核磁共振仪、超声、呼吸机、影像采集系统等
其他	安防、照明、消费电子、智能家电、军工等
前沿领域	如低空经济、机器人、AI服务器电源、海洋经济等

(三)主要经营模式

公司经营模式主要是结合公司所处行业特点、上下游行业的发展情况以及自身所处的发展阶段等因素综合考虑后,根据多年经营管理的实践经验形成的。公司目前已形成较为成熟、完善的采购、生产和销售等管理体系。公司主要经营模式近年来未发生重大变化。

1、采购模式

公司主营产品为多品种的定制化印制电路板产品,产品生产所需的原材料规格、型号、种类较多,产品生产具有多品种、多批次、设计规格各异的特点。为满足不同客户不同批次订单对原材料参数以及PCB的基材、厚度、尺寸等要素的多样化需求,并保证产品按时生产和交付,公司制定了相配套的采购机制和库存标准,采用"以产定购"与"保持适当安全库存量"相结合的采购模式。采购部根据生产所需的原材料种类、型号、数量等要素对原材料进行采购,以适应多品种、多批次生产模式的需要,同时对于普遍、通用的原材料,公司会根据日常消耗量确定安全库存,在保证最小安全库存的前提下,进行备货采购,持续优化采购成本,保障物资供应的及时性和稳定性,确保原材料可以高效快速地供给生产。公司设有专门的采购部门,采购部具体负责原材料采购和供应商的开发管理,借助ERP、SRM等供应链系统,打造集团数字化采购平台,实现采购的流程化、标准化和规范化,并对供应商实施考评,选择优质供应商并纳入合格供应商库。

2、生产模式

由于公司生产的产品为定制化产品,公司基本采取以销定产的生产模式,根据订单组织安排生产。同时,由于产品订单具有"多品种、多批次、短交期"的特点,对生产线布局、生产排产、生产技术、生产过程管理及人员技能等方面的要求较高,公司建立了高度柔性化的生产管理体系以及与之相匹配的企业文化。计划部根据市场部下发的订单制定生产计划,对生产排期、物料和工具管理等进行统筹安排,协调生产部、采购部、工程部和设备部等相关部门,借助公司内部成熟的ERP和MES智能制造系统保障生产的快速有序推进。同时,公司会定期组织对一线员工进行多岗位、多流程环节交叉培训,使员工能胜任不同岗位及不同工艺流程的工作,提高人员安排的灵活性。

3、销售模式

公司产品具有"多品种、多批次、短交期"的特点,同时面向境内外客户销售,已形成完整的境内外销售体系。销售部负责对客户和订单进行管理,其下设境内销售组和境外销售组,分别负责国内市场和国外市场的销售。香港本川作为境外销售的主要平台,美国本川则主要负责美国地区的客户拓展及服务。

根据客户类型和国内外市场的特点,公司采取向电子产品制造商直接销售和通过贸易商覆盖下游客户两种销售模式。公司在国内市场主要采用向电子产品制造商直接销售的方式,在国外市场主要采用向电子产品制造商直接销售与通过贸易商覆盖下游客户相结合的方式。公司主要通过竞争性谈判和招投标等方式与客户建立合作关系,并确定产品价格。公司客户数量众多,客户类型主要包括电子产品制造商与PCB贸易商两类。公司主要通过建立海外本土营销团队、主动开发下游客户、现有客户介绍、客户主动联系等方式获取新客户。

4、外协加工模式

印制电路板存在生产工艺流程复杂、设备投资金额大、客户订单不均衡等特点,将外协加工作为组织生产的补充是印制电路板行业普遍采取的模式。此外,客户对产品交期及产品加工类型的多样性有更高的要求,出现订单不均衡、峰值产能不足的情况频率更高。公司采用"多品种、多批次、短交期"的业务模式,在组织生产时公司会优先利用自有生产线组织生产,当自有产能无法满足生产计划时,公司会将部分工序或少量中低端产品全制程委托外协加工商进行加工,在保证质量的情况下,满足客户短时间内快速交付的要求。

5、研发模式

公司自成立以来一直注重技术研发,积累了多项专利和非专利技术。在全面发展生产技术的同时,公司还追求差异化,专注细分领域的研发创新,建立差异化的技术优势。通过研发技术的应用,公司提高了生产效率,降低了生产成本,提升了产品质量,缩短了交货周期,提高了市场竞争力。公司通过与客户及供应商开展紧密的研发设计合作,及时跟踪市场需求,积极发现处于发展起步阶段且未来发展空间广阔的细分领域,合理选择研发项目,针对性地研究开发,以提高公司生产技术及研发的优势。

为不断提高企业自主创新能力,公司全方位推进高层次创新人才队伍建设,目前公司已打造一支紧跟市场需求、研发经验丰富、成果转化高效的高素质研发团队。公司研发创新机制坚持"以客户为中心,以市场为导向"的模式,紧密结合国内外市场发展需求,建立健全的绩效激励机制和人才培养体系,引导全体员工进行技术创新。

(四)主营业务分析

2024年,公司按照既定发展战略,积极应对行业竞争,不断提升经营管理水平,在全体公司员工的共同努力之下,公司经营稳中有进,经营效益得到快速提升,现将全年主要工作情况总结如下:

1、经营业绩

2024年度,公司主要经营指标得到稳步提升,公司实现营业收入5.96亿元,同比增长16.67%;实现利润总额0.28亿元,同比增长5,553.74%;归属于上市公司股东的净利润0.24亿元,同比增长391.81%;公司主营业务毛利率12.42%,同比增加0.82个百分点。从公司PCB应用领域来看,公司在汽车电子、新能源、电力等领域的营业收入均实现不同程度的增长。

报告期内,公司"年产48万平高频高速、多层及高密度印制电路板生产线扩建项目""年产52万平5G高频高速通信电路板项目"等项目进展顺利,为订单导入提供了有力的产能支撑,公司产量大幅增加,稼动率维持在较高水平,订单交付能力大幅提升,规模效应下盈利能力得到快速提升。

2024年度,公司印制电路板产量达到87.98万平方米,较去年同期增加约31.82%;印制电路板销量达84.54万平方米,较去年同期增加约28.40%;公司PCB业务规模不断扩大,产能利用率进一步提升,销售量和生产量保持稳步增长。

截至本报告期末,公司资产总额约13.10亿元,负债总额约3.17亿元,所有者权益总额约9.93亿元,资产负债率约为24.21%,较去年同期减少约0.17个百分点。公司资产负债率处于行业较低水平,公司偿债能力较强,整体财务状况较为稳健。

2、市场拓展与产品布局

2024年度,公司始终坚持"以客户为中心,以市场为导向"的发展方针,公司持续加大对电机、电控、储能、充电桩、机器人等新兴市场的拓展力度,积极引入新客户,客户导入工作有序推进,全年承接的订单金额同比增加23.40%;公司积极调整订单结构,积极布局高多层板、HDI、刚挠结合板、特殊金属基板等高附加值产品,公司多层PCB收入占主营业务收入的比重同比增加3.64个百分点。公司把握行业结构性机会,加大布局高附加值领域,进一步优化公司产品结构。

公司积极把握汽车电动化与智能化趋势带来的增量机会,订单需求持续释放,公司汽车电子、新能源等营业收入保持稳定增长。公司产品结构、产品结构以及客户结构不断得到优化布局,公司市场竞争能力得到进一步提升,优质客户群体不断扩大,未来将持续深化合作关系,不断增强合作粘性,提高公司的盈利能力。

报告期内,公司客户数量同比增加14.52%。公司积极围绕战略发展目标,把握行业发展机会和市场需求,加大客户维护和开发力度,增强与原有客户合作力度,深度挖掘客户需求,有序推进新客户开发工作,壮大优质客户群体,公司服务的活跃客户近千家,其中上市公司约百余家,稳定优质的客户资源为公司的未来发展奠定了坚实的基础。

3、技术创新与研发投入

2024年度,公司累计投入研发费用0.31亿元,同比增长4.77%。公司高度重视技术与产品的研发工作,持续加大研发投入规模,不断提升公司的研发和技术创新能力。报告期内,公司研发投入占营收比重为5.18%。截至2024年12月31日,公司及其子公司共计拥有79项专利,其中发明专利23项,实用新型专利56项。此外,公司基于长期以来的技术积累,形成了涵盖高频高速、高多层、刚挠结合、多层软板、金属基材、厚铜、HDI等多种产品的核心技术,为开发新产品、提高生产效率提供了有效支持。

同时,公司积极寻求与高校建立产学研合作关系的机会,共同进行前沿技术研究和人才培养,致力于将研究成果快速转化为实际应用产品。公司持续加强研发投入,结合客户和市场的实际需求,专注于细分领域的技术研发,打造核心技术优势,不断保持技术领先优势。

4、产能建设与规划

2024年度,公司南京"年产48万平高频高速、多层及高密度印制电路板生产线扩建项目"产能利用率较2023年度显著改善,多项运营管理指标显著提升,公司经营运行质量持续向好。公司在南京投资建设的"5G高频高速通信电路板项目",产能规划52万平方米,建设项目正在稳步推进中,具体产能释放情况将根据市场需求和公司生产计划逐步提升,为公司进一步提升主营业务规模奠定了坚实的基础。

公司于2024年度收购了珠海硕鸿工厂,产能规划40万平方米,整合工作正在按计划稳步推进中,并将逐步实现产能提升目标,确保珠海硕鸿快速融入公司整体战略,并着力将珠海硕鸿打造成公司华南地区的重要生产中心,以满足华南、珠三角地区客户的高质量、快速交付订单需求。公司将在珠海拥有以珠海硕鸿为中心的三个生产基地,即珠海硕鸿、珠海亚图、皖粤光电,形成高质量发展格局。

此外,为顺利推进泰国生产基地的建设,满足营运资金的需求,公司已完成以自有资金向泰国子公司的增资,本次增资完成后泰国子公司的注册资本由300万泰铢增加至30,000万泰铢,公司将积极推进泰国生产基地的建设,满足海外客户的市场需求。

5、对外投资

2024年度,公司为推动在重点行业和领域的战略布局,进一步提升公司的核心竞争力,提高公司的资本运作效益,以自有资金3,000万元共同投资设立深圳保腾福顺创业投资基金合伙企业(有限合伙)。公司本次参与设立创业投资基金是在保证公司主营业务正常发展的前提下,借助专业投资机构的行业资源、基金运作及丰富投资管理经验,通过专业的前沿研究和投资能力,整合各方资源,布局与公司主营业务具有相关性、协同性的领域,帮助公司深入发掘产业链投资机会,为公司主营业务提供上下游产业和资源支持,有助于加快公司发展战略的实施、夯实主营业务实力,从而提升公司的盈利能力和综合竞争力。

2024年度,公司以自有资金收购股权及增资皖粤光电,本次投资契合公司发展战略,符合公司经营发展需要。皖粤光电是一家专业从事热电分离铜基板、镜面铝基板、陶瓷基板等特殊材料工艺PCB产品研发、生产和销售的制造企业,拥有专业、独立的生产场所及管理团队,其核心团队在该领域具备丰富经验。通过协调公司和皖粤光电的产业资源,发挥协同效应,优势互补,有助于加快公司产业布局,丰富公司产品体系,拓宽下游应用领域,丰富客户资源,提高公司品牌知名度,使得公司成为国内少数拥有高频高速板、厚铜板、多功能金属基板、陶瓷基板、挠性板、刚挠结合板、HDI板等多种新技术方向和特殊材料前沿产品生产能力的厂商之一,提升公司综合竞争能力及整体盈利能力,实现公司战略目标,促进公司长期可持续发展。

6、信息化建设

2024年度,公司不断加码信息化建设,持续提升生产制造环节的智能化、自动化、信息化、精益化管理水平,建成了契合公司经营发展规模的信息化、数字化管理平台,处于行业前沿水平。公司新建工厂的智能化、自动化、信息化程度普遍较高,工厂全线规划自动化投板、自动化收板、自动导向车(AGV)运输,配合自动物流搬运、精准物流配送和管理等实现厂区多维度的智能化。同时以MES系统为核心,集成控制自动化、自动物流、产品追溯和自动计划系统,实现了自动化和少人化作业。

公司通过智能排程系统(APS),依据订单优先级、交货期、生产工艺等因素,智能分配生产资源,自动生成生产计划,并在生产过程中动态调整。通过合理安排生产顺序和资源分配,减少设备闲置和人员等待时间,提升整体生产效率,确保高优先级订单、紧急订单能够按时或提前交付,其他各类订单能够按照要求的时间依次按时交付,满足客户需求,增强客户对公司的信任和满意度,并根据订单优先级合理调配设备、人力和物料等资源,实现资源的高效利用,降低了生产成本。

通过信息化建设,公司的组织、生产、服务效率显著提升,产品可靠性和稳定性实现了全面保障和可追溯。公司整体生产经营效率得到提升,产品的良率大幅提升,产品交期也大幅缩短。

7、投资者关系管理

报告期内,公司高度重视投资者关系管理工作。公司根据经营的实际情况,结合规范运作的各项要求,积极履行信息披露义务,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平,通过电话、电子邮件、投资者关系互动平台、机构调研等方式积极与投资者互动,建立了良好的沟通渠道,增进投资者对公司的了解,加强公司与投资者之间的良性互动,维护公司与投资者之间的良好关系,树立公司良好的资本市场形象,持续向市场传递公司价值。公司制定了连续、稳定的利润分配政策,具体利润分配方式结合公司利润实现状况、现金流量状况和股本规模进行决定,并充分考虑独立董事和公众投资者的意见,合理回报股东、投资者。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,309,758,027.63	1,316,965,973.91	-0.55%	1,370,953,723.61
归属于上市公司股东的净资产	990,833,624.63	995,831,729.37	-0.50%	1,008,102,508.77
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	596,102,698.78	510,942,612.61	16.67%	559,263,353.92
归属于上市公司股东的净利润	23,739,607.27	4,826,943.09	391.81%	47,553,879.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,970,433.68	-6,739,265.05	351.81%	32,759,863.51
经营活动产生的现金流量净额	28,184,642.18	74,599,903.37	-62.22%	110,450,232.26
基本每股收益(元/股)	0.3072	0.0626	390.73%	0.62
稀释每股收益(元/股)	0.3063	0.0623	391.65%	0.62
加权平均净资产收益率	2.35%	0.47%	1.88%	4.74%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	122,425,040.49	154,943,286.84	151,369,467.27	167,364,904.18
归属于上市公司股东的净利润	7,196,212.51	8,430,159.15	5,544,437.66	2,568,797.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,595,631.30	6,794,053.38	3,051,738.13	4,529,010.87
经营活动产生的现金流量净额	10,828,704.70	-1,785,534.99	22,473,036.84	-3,331,564.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,127	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,706	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量
董晓俊	境内自然人	24.32%	18,802,000.00	14,101,500.00	质押	7,230,000.00
南京瑞瀚股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	19.92%	15,400,000.00	0.00	不适用	0.00
周国雄	境内自然人	7.00%	5,413,300.00	4,059,975.00	不适用	0.00
江培来	境内自然人	5.09%	3,937,500.00	3,937,500.00	不适用	0.00
黄庆娥	境内自然人	1.94%	1,499,500.00	0.00	不适用	0.00
江东城	境内自然人	1.56%	1,208,500.00	921,375.00	不适用	0.00
李伟国	境内自然人	0.86%	662,500.00	0.00	不适用	0.00
陈君玉	境内自然人	0.84%	650,000.00	0.00	不适用	0.00
邓琼添	境内自然人	0.74%	570,500.00	0.00	不适用	0.00
潘明小	境内自然人	0.39%	300,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、董晓俊、周国雄、江培来、黄庆娥、江东城分别持有南京瑞瀚股权投资合伙企业(有限合伙)53.72%、17.60%、15.00%、9.00%和4.68%的合伙份额;且董晓俊担任南京瑞瀚股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;2、除上述股东之间的关联关系外,公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

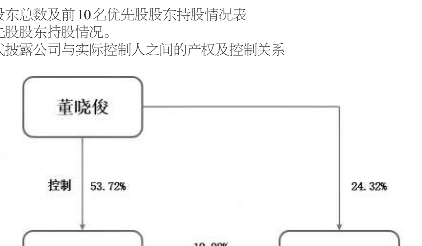
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司通过临时公告披露的重大事项如下:

序号	其他重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1	关于回购股份实施结果暨股份变动公告	2024年1月15日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-002)
2	关于更换第三届董事会审计委员会部分委员的公告	2024年1月29日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-004)
3	关于为全资子公司提供担保的公告	2024年1月29日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-005)
4	2023年年度业绩预告	2024年1月30日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-006)
5	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	2024年2月27日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-010)
6	关于修订《公司章程》并制定、修订部分内部控制管理制度的公告	2024年2月27日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-011)
7	关于董事兼高级管理人员股份减持计划时间届满未减持股份的公告	2024年3月4日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-013)
8	关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告	2024年3月15日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-015)
9	关于公司特定股东减持股份的预披露公告	2024年3月25日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-016)
10	关于向泰国子公司增资及完成注册资本变更登记的公告	2024年4月30日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-032)
11	关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告	2024年5月8日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-033)
12	2023年年度权益分派实施公告	2024年6月5日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-036)
13	2024年半年度业绩预告	2024年7月22日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-038)
14	关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	2024年8月1日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-039)
15	关于特定股东股份减持计划时间届满的公告	2024年8月1日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-040)
16	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的公告	2024年8月8日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-043)
17	关于开展外汇套期保值业务的公告	2024年8月8日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-044)
18	关于与专业投资机构共同投资的公告	2024年9月3日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-053)
19	关于以自有资金收购股权及增资的公告	2024年9月20日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-055)
20	关于更换保荐代表人的公告	2024年9月26日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-057)
21	关于以自有资金收购股权的公告	2024年10月26日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-062)
22	关于与专业投资机构共同投资的进展公告	2024年10月28日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-064)
23	关于控股子公司完成工商变更登记的公告	2024年10月31日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-065)
24	关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告	2024年10月31日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-066)
25	关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告	2024年11月25日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-068)
26	关于全资子公司完成工商变更登记的公告	2024年12月2日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-069)
27	关于与专业投资机构共同投资的进展公告	2024年12月3日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-070)
28	关于董事兼高级管理人员减持股份的预披露公告	2024年12月9日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-071)
29	关于以自有资金收购股权的进展公告	2024年12月10日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-072)
30	关于部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构的公告	2024年12月14日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-075)
31	关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告	2024年12月24日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-077)
32	关于董事兼高级管理人员股份变动比例超过1%的公告	2024年12月31日	巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn(公告编号:2024-079)

(上接B390版)

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

芯原微电子(上海)股份有限公司董事会
2025年4月26日

附表1:募集资金使用情况对照表

附表1

募集资金使用情况对照表

编制单位:芯原微电子(上海)股份有限公司

单位:人民币元

募集资金总额	1,677,953,077.52	本年度投入募集资金总额	80,993,169.21
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	1,736,728,352.89
变更用途的募集资金总额比例(%)	0.00		

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额③=②-①	截至期末投入进度(%)④=②/①	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、承诺投资项目												
智慧汽车的IP应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目	否	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	1,014,644.58	151,131,473.56	1,131,473.56	100.75	2024年	不适用	不适用	否
智慧家居和智慧城市的IP应用方案和芯片定制平台项目	否	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	-	113,486,346.90	3,486,346.90	103.17	2022年	不适用	不适用	否
智慧可穿戴设备的IP应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目	否	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	-	111,664,603.67	1,664,603.67	101.51	2022年	不适用	不适用	否
智慧云平台系统级芯片定制平台的开发及产业化项目	否	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	-	118,967,830.18	-1,032,169.82	99.14	2022年	不适用	不适用	否
研发中心升级项目	否	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	-	308,327,829.51	8,327,829.51	102.78	2022年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	790,000,000.00	790,000,000.00	790,000,000.00	1,014,644.58	803,578,083.82	13,578,083.82	101.72	-			
二、超募资金投向												
永久补充流动资金	否	535,678,253.04	535,678,253.04	535,678,253.04	4,678,253.04	535,678,253.04	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	390,000,000.00	390,000,000.00	390,000,000.00	75,300,271.59	397,472,016.03	7,472,016.03	101.92	2024年	不适用	不适用	否
超募资金小计	-	925,678,253.04	925,678,253.04	925,678,253.04	79,978,524.63	933,150,269.07	7,472,016.03	100.81	-			
合计(注)	-	1,715,678,253.04	1,715,678,253.04	1,715,678,253.04	80,993,169.21	1,736,728,352.89	21,050,099.85	101.23	-		-	-

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告之"三、(二)对暂时闲置募集资金的现金管理情况"相关内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本报告之"三、(三)使用超募资金永久补充流动资金情况"相关内容。
募集资金结余的金额及形成原因	基于智慧汽车的IP应用方案和系统级芯片定制平台的开发及产业化项目的实施安排,上述项目已于报告期内完成,结余募集资金(包括利息收入)192.96万元已全额结转补充流动资金。
募集资金其他使用情况	不适用

注:募集资金承诺投资金额大于实际募集资金净额的原因系超募资金用于永久补充流动资金的金额含超募资金利息收入及理财产品收益。

证券代码:688521 证券简称:芯原股份 公告编号:2025-018

芯原微电子(上海)股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响:公司本次预计的日常关联交易基于公司未来的经营计划所制定,以满足公司日常生产经营的需要。关联交易遵循公平、合理的原则,双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。公司的关联交易价格公允,未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不产生任何不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第二届董事会第二十一次会议暨2024年年度董事会,审议通过了《关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案》,预计未来一年(即自2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止)的日常关联交易总额度67,000.00万元。关联董事Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)、Wei-Jin Dai(戴伟进)、施文茜、陈晓飞、孙国栋回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事专门会议已对上述议案所涉事项进行审议并形成决议,认为:公司未来一年(即自2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止,下同)预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正原则开展的,不存在损害公司和全体股东的利益的情形。公司在不断致力于减少关联交易的同时,与关联方的关联交易将继续遵循公平、合理的原则,双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。公司未来一年预计发生的关联交易价格公允,不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意将本议案提交公司董事会会议审议。

本事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关事项回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	芯思原微电子有限公司(以下简称"芯思原")	3,200.00	3.51%	202.76	371.90	0.41%	基于日常经营及业务自然发展
	Alphawave IP Inc.(以下简称"Alphawave")	20,000.00	21.96%	2,173.84	3,979.00	4.37%	
	威视芯半导体(合肥)有限公司(以下简称"威视芯")	2,000.00	8.62%	-	-	-	
	湖南越摩先进半导体有限公司(以下简称"湖南越摩")	2,500.00	17.22%	375.65	1,819.08	12.53%	
	Silicon Box Pte Ltd(以下简称"Silicon Box")	2,000.00	13.78%	-	-	-	
	鹏瞰集成电路(杭州)有限公司(以下简称"鹏瞰")	4,000.00	4.39%	-	256.66	0.28%	
	至成微科技(浙江)有限公司(以下简称"至成微")	1,600.00	0.93%	645.00	-	-	
	南京迈矽科微电子科技有限公司(以下简称"迈矽科")	1,000.00	4.31%	-	-	-	
	Ventana Micro Systems Inc.(以下简称"Ventana")	3,000.00	12.93%	-	-	-	
	Blue Cheetah Analog Design, Inc.(以下简称"Blue Cheetah")	1,500.00	6.46%	-	-	-	
	Expedera,Inc(以下简称"Expedera")	2,500.00	10.77%	-	-	-	
	小计	43,300.00	-	3,397.24	6,426.64	-	-
向关联人销售产品、商品	芯思原	2,000.00	0.90%	4.61	26.67	0.01%	基于日常经营及业务自然发展
	迈矽科	1,000.00	0.45%	-	-	-	
	至成微	2,000.00	0.90%	-	729.26	0.33%	
	兆易创新科技集团股份有限公司(以下简称"兆易创新")	5,000.00	3.68%	847.49	742.53	0.55%	
	广州增芯科技有限公司(以下简称"增芯科技")	2,000.00	1.47%	-	552.46	0.41%	
	威视芯	700.00	0.32%	-	-	-	
	上海华力集成电路制造有限公司(以下简称"上海华力")	2,300.00	1.69%	131.49	-	-	
	鹏瞰	2,000.00	0.90%	-	-	-	
	上海开放处理器产业创新中心	100.00	0.12%	-	-	-	
	华虹半导体(无锡)有限公司(以下简称"华虹无锡")	1,000.00	0.74%	-	-	-	
	Ventana	2,500.00	1.13%	-	-	-	
	DreamBig Semiconductor Inc.(以下简称"Dreambig")	800.00	1.10%	-	-	-	
	FLC Tecnology Group Inc.(以下简称"FLC")	800.00	1.10%	-	-	-	
	Zerro Power Systems Pte Ltd(以下简称"Zerro Power")	1,500.00	0.95%	-	-	-	
	小计	23,700.00	-	983.58	2,050.92	-	-
合计		67,000.00	-	4,380.39	8,477.56	-	-

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	报告期内发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	芯思原	2,600.00	371.90	基于双方业务自然发展,并结合下游市场需求情况,采购金额低于预计金额
	Alphawave	25,000.00	3,979.00	
	威视芯	2,300.00	-	
	湖南越摩	6,000.00	1,819.08	
	智瀚星途	300.00	175.00	
	Silicon box	1,000.00	-	
	鹏瞰	1,800.00	256.66	
	至成微	700.00	-	
	小计	39,700.00	6,601.64	-
向关联人销售产品、商品	芯思原	3,000.00	26.67	基于双方业务自然发展,并结合下游市场需求情况,销售金额低于预计金额
	迈矽科	2,000.00	-	
	至成微	4,300.00	729.26	
	智瀚星途	1,000.00	-	
	兆易创新	3,000.00	742.53	
	广州增芯	2,800.00	552.46	
	威视芯	800.00	-	
	上海华力	500.00	-	
	小计	17,400.00	2,050.92	-
合计		57,100.00	8,652.56	-

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人基本情况

1、芯思原

芯思原成立于2018年,注册资本13,333.3333 万元人民币,法定代表人为Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民),注册地址为合肥市高新区望江西路800号创新产业园二期J2栋A座20层。其经营范围为集成电路芯片设计及服务;一般项目:集成电路芯片设计及服务;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;电子产品销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。根据工商登记口径,芯思原前五大股东持股情况为:公司持股42.00%,共青城如愿投资合伙企业(有限合伙)持股20.00%,嘉兴芯谷投资合伙企业(有限合伙)持股15.00%,国科新能(合肥)智能电动汽车创业投资合伙企业(有限合伙)持股9.38%,井冈山滨橙创业投资合伙企业(有限合伙)持股6.37%。

2024年末,芯思原经审计总资产为2,728.07万元,净资产为-3,200.78万元;2024年度,芯思原实现营业收入1,976.51万元,净利润-4,750.10万元。

2、Alphawave

Alphawave成立于2017年,是一家总部位于加拿大多伦多的面向电子设备的多标准IP互联解决方案的领先供应商。Alphawave主营业务为多标准SerDes IP核及Chiplet解决方案提供商,拥有面向多个终端市场(数据中心、网络通讯、AI、自动驾驶、5G通信、存储等)的广泛产品组合,其总裁兼首席执行官为Tony Pialis先生。Alphawave未公开披露财务数据,其母公司Alphawave IP Group为伦敦证券交易所上市公司(股票代码:AWE.L)。

根据Alphawave IP Group2024年年度报告,截至2024年末,Alphawave IP Group总资产106,940万美元,净资产48,980万美元;2024年度,Alphawave IP Group营业收入30,760万美元,净利润-4,250万美元。

3、威视芯

威视芯成立于2018年,注册资本1,857.565415万美元,法定代表人为陈国敏,注册地址为合肥市高新区创新产业园二期J1楼A座13层天翅创众创空间A5办公区。其经营范围为半导体科技、计算机软件科技、计算机网络科技、集成电路芯片科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;集成电路芯片设计及服务;计算机软、硬件的批发;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。根据工商登记口径,威视芯前五大股东持股情况为:共青城威视芯投资合伙企业(有限合伙)持股24.32%,合肥高新产业投资有限公司持股13.55%,青岛华晟君辉投资合伙企业(有限合伙)持股13.55%,合肥东芯通信股份有限公司8.11%,姚冲持股7.00%。截至目前,公司持股比例为5.40%。

2024年末,威视芯总资产为7,633万元,净资产为-4,009万元;2024年度,威视芯实现营业收入2,327.88万元,净利润-2,145.87万元(以上数据未经审计)。

4、湖南越摩

湖南越摩成立于2020年,注册资本46,650万元人民币,法定代表人何新文,注册地址为湖南省株洲市石峰区云霞大道686号。其经营范围为一般项目:半导体分立器件制造;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路制造;电力电子元器件制造;集成电路销售;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。根据工商登记口径,湖南越摩前五大股东持股情况为:株洲超越摩尔创业投资合伙企业(有限合伙)持股45.02%,湖南超摩半导体合伙企业(有限合伙)持股30.01%,株洲宁橙创业投资合伙企业(有限合伙)持股12.11%,株洲市国投创新创业投资有限公司持股8.47%,海南臻盈投资合伙企业(有限合伙)持股3.11%。

2024年末,湖南越摩总资产为81,942.93万元,净资产为25,413.13万元;2024年度,湖南越摩实现营业收入10,204.45万元,净利润-12,819.90万元。(以上数据未经审计)。

5、Silicon Box

Silicon Box成立于2021年,总部位于新加坡,是一家半导体先进封装服务提供商,可以提供从设计到Chiplet最终制造服务。其创始人为Byung Joon Han先生、Sehat Sutardja先生、Weili Dai女士,Byung Joon Han先生为首席执行官。

截至2024年末,Silicon Box总资产为53,431万美元,净资产为45,851万美元;Silicon Box实现营业收入187万美元,净利润3099万美元(以上数据未经审计)。

6、鹏瞰

鹏瞰成立于2019年,注册资本2,060.9573万元人民币,法定代表人江晓峰,注册地址为浙江省杭州市上城区顺福商务中心1幢1001室。其经营范围为一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路销售;集成电路芯片设计及服务;软件开发;信息技术咨询服务;网络与信息安全软件开发;物联网技术服务;货物进出口;技术进出口;通信设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。根据工商登记口径,鹏瞰前五大股东持股情况为:VULCAN HOLDING HONGKONG LIMITED持股26.1440%,上海芯盛企业管理中心(有限合伙)持股11.9167%,天海智芯(天津)管理咨询合伙企业(有限合伙)持股8.3333%,义乌华芯远景创业投资中心(有限合伙)持股6.6667%,义乌韦豪鋆轩一期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股6.4239%。

截至2024年末,鹏瞰总资产为10,930.5万元,净资产为6,625.5万元;2024年度,鹏瞰实现营业收入2,361.76万元,净利润-4,039.52万元(以上数据未经审计)。

7、迈矽科

迈矽科成立于2016年,注册资本为1382.1053万元,法定代表人为侯德彬,注册地址为南京市江宁区秣周东路9号(江宁开发区),其经营范围为电子产品的研发、销售、技术咨询、技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),一般项目:电子元器件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。根据工商登记口径,迈矽科前五大股东持股情况为:南京玄木软件科技企业(有限合伙)持股29.67%,南京夕木软件科技合伙企业(有限合伙)持股10.23%,侯德彬持股10.13%,施韵持股8.57%,冯川持股8.57%。截至目前,公司持股比例为2.31%。

2024年末,迈矽科总资产为7,909万元,净资产为6,173万元;2024年度,迈矽科实现营业收入2,606万元,净利润-396万元(以上数据未经审计)。

8、至成微

至成微成立于2021年,注册资本1,409.79万元人民币,法定代表人为成飞,注册地址为浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道东升路8号3号楼353室。其经营范围为一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;软件开发;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;电子元器件零售;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。根据工商登记口径,至成微前五大股东持股情况为:冠成壹号(嘉兴)管理咨询中心(有限合伙)持股29.79%,成飞持股26.96%,冠成贰号(嘉兴)管理咨询中心(有限合伙)持股14.19%,聚源信诚(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)持股5.46%,嘉善芯创壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股4.09%。截至目前,公司持股比例为2.73%。

2024年末,至成微经审计总资产为2,717.73万元,净资产为1,599.09万元;2024年度,至成微实现营业收入1,518.16万元,净利润-3,783.86万元。

9、兆易创新

兆易创新(股票代码:603986)成立于2005年,注册资本66,412.4105万元人民币(工商登记口径),法定代表人何卫,注册地址为北京市海淀区丰豪东路9号院8号楼1至5层101。其经营范围为微电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成、电信设备、手持移动终端的研发;委托加工生产、销售自行研发的产品;技术转让、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至本公告披露日,兆易创新尚未披露2024年年度报告。截至2023年末,兆易创新总资产1,645,578.36万元,净资产1,519,957.66 万元;2023年度,兆易创新实现营业收入576,082.34万元,净利润16,114.12万元。

10、增芯科技

增芯科技成立于2021年,注册资本为682,000万元,法定代表人为陈晓飞,注册地址为广州市增城区宁西街创优路333号,其经营范围为物联网设备制造;电子专用材料制造;电子专用材料研发;集成电路销售;集成电路芯片设计及服务;非居住房地产租赁;集成电路设计;半导体器件专用设备销售;半导体器件专用设备制造;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件批发;集成电路芯片及产品销售;半导体分立器件制造;集成电路制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路芯片及产品制造;电子专用设备销售;半导体分立器件销售;光电子器件销售;电子专用设备制造;电子产品销售;光电子器件制造;电子专用材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;物联网设备销售;专业设计服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;机械设备租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);进出口代理;货物进出口;技术进出口。根据工商登记口径,增芯科技前五大股东持股情况为:广州湾区智能传感器产业集团有限公司持股43.99%,福建金盛兰科创投资有限公司持股11.36%,广州东进微技术股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股10.26%。山西新民能源投资集团有限公司持股7.33%,井冈山慧芯股权投资合伙企业(有限合伙)持股6.60%。

11、上海华力

上海华力成立于 2016 年,注册资本为 2,960,000 万元人民币, 法定代表人为张素心,注册地址为上海市浦东新区良腾路 6 号,其经营范围为开发、设计、加工、制造和销售集成电路和相关产品,从事货物与技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。根据工商登记口径,上海华力前五大股东持股情况为:上海华力微电子有限公司持股 54.0541%,国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股 39.1892%,上海集成电路产业投资基金股份有限公司持股 6.7568%。

12、上海开放处理器产业创新中心

上海开放处理器产业创新中心成立于2024年,注册资本为100万元人民币, 法定代表人为赵英丹,其地址为上海市浦东新区集创路52号创芯天地一号楼15F,其业务范围为开展处理器及其产业创新研究、研究成果转化、相关人才培养,提供技术咨询、合作交流等服务,承接各单位委托的相关事项。

13、华虹无锡

华虹无锡成立于2017年,注册资本为 253685.180069万美元,法定代表人为唐均君,注册地址为无锡国家高新技术产业开发区(无锡市新吴区)市场监督管理局,其经营范围为集成电路产品的设计、开发、制造、测试、封装、销售及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。根据工商登记口径,华虹无锡前五大股东持股情况为:上海华虹宏力半导体制造有限公司持股28.7778%,华虹半导体有限公司持股22.2222%,国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股20.5767%,无锡锡虹联芯投资有限公司持股20%,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持股8.4233%。

14、Ventana

Ventana成立于2018年,总部位于美国加利福尼亚州库比蒂诺,专注于为计算领域提供基于RISC-V架构的CPU技术。该公司开发数据中心级高性能CPU,配备可扩展指令集,以多核芯粒(Chiplets)或核心IP形式交付,主要应用于云计算、企业数据中心、超大规模基础设施、5G通信、边缘计算、人工智能/机器学习(AI/ML)及汽车市场。

15、Blue Cheetah

Blue Cheetah 成立于 2018 年,总部位于加利福尼亚州旧金山,专注于为半导体行业提供裸片间互连(Die-to-Die)IP解决方案。该公司开发的互连技术包含物理层及可选的链路层芯粒(Chiplet)接口,适配多种先进封装场景,并兼容多类开放标准。其产品主要应用于高性能计算、人工智能及移动通信市场。

16、Expedera

Expedera成立于2018年,总部位于加利福尼亚州圣克拉拉,在英国、中国、日本、台湾、新加坡和印度设有工程开发中心和客户支持办事处。该公司专注于为人工智能(AI)行业提供可扩展的神经网络处理器IP。该公司的核心产品为神经处理单元(NPU)解决方案,通过优化硬件架构设计,在提升算力性能与能效的同时降低系统成本及复杂度,赋能多样化AI应用场景。其技术覆盖从可穿戴设备、智能手机、汽车电子系统到数据中心等广泛领域。

17、DreamBig

DreamBig 成立于 2019 年,总部位于加利福尼亚州圣何塞,专注于人工智能、数据中心、5G通信及汽车电子市场提供解决方案。该公司推出的芯粒(Chiplet)技术平台,通过集成计算芯粒、加速器芯粒、存储芯粒、IO接口芯粒以及网络加速器芯片组,助力客户打造具备差异化竞争优势的产品组合,同时显著增强设备互连能力。

18、FLC

FLC成立于 2016 年,总部位于加利福尼亚州圣克拉拉,致力于计算机存储技术授权及相关产品研发、生产。

19、Zerro Power

Zerro Power Systems成立于 2017 年,总部位于新加坡,专注于科技领域电力电子专用集成电路(ASIC)设计的公司。该企业主要致力于开发用于电机驱动器和冷却风扇控制器的集成电路解决方案,核心业务聚焦于为需要先进电源管理技术的行业提供专业支持。

上述部分关联方未对外公开财务数据,也未向公司提供相关数据,故部分财务数据无法取得。

(二)与公司的关联关系

关联人	关联关系
芯思原	公司董事及高级管理人员Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)担任其董事长兼总经理,董事、副总裁、首席财务官、董事会秘书施文茜担任其董事
Alphawave	公司董事及高级管理人员Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)及董事及高级管理人员Wei-Jin Dai(戴伟进)之妹Weili Dai(戴伟立)担任其董事,Weili Dai(戴伟立)丈夫Sehat Sutardja(周秀文)过去12个月内曾担任其董事
威视芯	公司高级管理人员汪志伟担任其董事
湖南越摩	公司董事陈晓飞间接控制该企业
Silicon Box	公司董事及高级管理人员Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)及董事及高级管理人员Wei-Jin Dai(戴伟进)的妹夫Sehat Sutardja(周秀文)过去12个月内曾担任其董事
鹏瞰	公司高级管理人员汪志伟担任其董事
至成微	公司高级管理人员汪洋担任其董事
迈矽科	公司高级管理人员汪志伟担任其董事
兆易创新	公司监事Zhiwei Wang(王志伟)担任其董事
增芯科技	公司董事陈晓飞间接控制并担任其董事长
上海华力	公司董事孙国栋担任其董事
华虹无锡	公司董事孙国栋担任其董事
Ventana	公司董事及高级管理人员Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)及董事及高级管理人员Wei-Jin Dai(戴伟进)的妹夫Sehat Sutardja(周秀文)过去12个月内曾担任其董事
Blue Cheetah	公司董事及高级管理人员Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)及董事及高级管理人员Wei-Jin Dai(戴伟进)的妹夫Sehat Sutardja(周秀文)过去12个月内曾担任其董事
Expedera	公司董事及高级管理人员Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)及董事及高级管理人员Wei-Jin Dai(戴伟进)的妹夫Sehat Sutardja(周秀文)过去12个月内曾担任其董事
DreamBig	公司董事及高级管理人员Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)及董事及高级管理人员Wei-Jin Dai(戴伟进)之妹Weili Dai(戴伟立)担任其高级管理人员,Weili Dai(戴伟立)丈夫Sehat Sutardja(周秀文)过去12个月内曾担任其高级管理人员
FLC	公司董事及高级管理人员Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)及董事及高级管理人员Wei-Jin Dai(戴伟进)之妹Weili Dai(戴伟立)控制且Weili Dai(戴伟立)担任其董事长,Weili Dai(戴伟立)丈夫Sehat Sutardja(周秀文)过去12个月内曾担任其高级管理人员
Zerro Power	公司董事及高级管理人员Wei-Jin Dai(戴伟进)及Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)及董事及高级管理人员Wei-Jin Dai(戴伟进)之妹Weili Dai(戴伟立)担任其董事

(三)履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营,财务状况良好,具备履约和支付能力。公司与上述关联方前次同类关联交易执行情况良好,至今为止未发生其对公司的应付款项形成坏账的情况,根据经验和合理判断,未来形成坏账的可能性很小。公司将与上述关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

(一)关联交易主要内容

公司与芯思原之间的关联交易主要为向其采购半导体IP及芯片设计服务,并对其销售半导体IP、芯片设计及量产服务。公司与Alphawave的关联交易主要为向其采购相关半导体IP及芯片设计服务。公司与威视芯之间的关联交易为向其采购半导体IP及相关服务,并对其销售半导体IP、芯片设计及量产服务。公司与湖南越摩之间的关联交易为向其采购封测服务。公司与Silicon Box之间的关联交易为向其采购封测服务。公司与鹏瞰之间的关联交易主要为向其采购半导体IP及芯片设计服务,并对其销售半导体IP、芯片设计及量产服务。公司与至成微之间的关联交易主要为向其采购半导体IP、芯片设计服务、晶圆及芯片,并对其销售半导体IP、芯片设计及量产服务。公司与迈矽科之间的关联交易主要为向其采购半导体IP及相关服务,并对其销售半导体IP、芯片设计及量产服务。公司与Ventana之间的关联交易主要为向其采购半导体IP及相关服务,并对其销售半导体IP、芯片设计及量产服务。公司与Blue Cheetah之间的关联交易主要为向其采购半导体IP及相关服务。公司与Expedera之间的关联交易主要为向其采购半导体IP及相关服务。公司与兆易创新之间的关联交易主要为对其销售半导体IP及芯片设计服务。公司与增芯科技之间的关联交易主要为对其销售半导体IP及芯片设计服务。公司与上海华力之间的关联交易主要为对其销售半导体IP及芯片设计服务。公司与上海开放处理器产业创新中心之间的关联交易主要为对其销售量产服务。公司与华虹无锡之间的关联交易为向其销售半导体IP及芯片设计服务。公司与DreamBig之间的关联交易主要为对其销售芯片设计服务。公司与FLC之间的关联交易主要为对其销售芯片设计服务。公司与Zerro Power之间的关联交易主要为对其销售芯片设计与量产服务。

上述关联交易均为公司开展日常经营活动所需,且所有交易均将订立书面协议,交易价格皆按公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据,由双方协商确定。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,上述日常关联交易符合相关法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《芯原微电子(上海)股份有限公司章程》的规定,定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,也不会影响公司的独立性。

五、上网公告附件

1.《芯原微电子(上海)股份有限公司第二届董事会独立董事第六次专门会议》;

特此公告。

芯原微电子(上海)股份有限公司董事会
2025年4月26日